

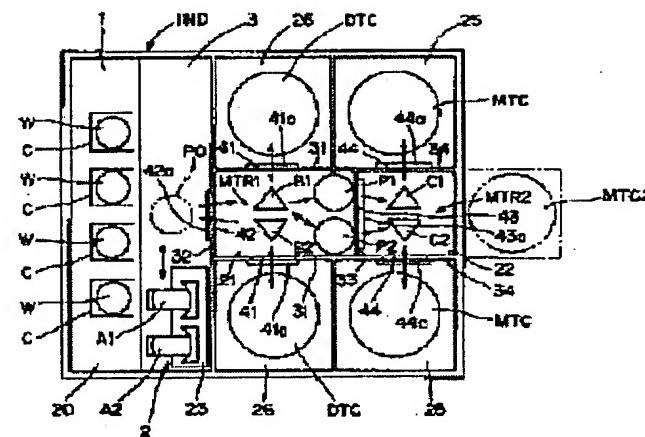
SUBSTRATE PROCESSOR

Patent number: JP10308430
Publication date: 1998-11-17
Inventor: MIZOHATA YASUHIRO; WATANABE JUN; KOYAMA YOSHIHIRO
Applicant: DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD
Classification:
- **international:** H01L21/68; B08B3/08; B08B3/12; H01L21/304
- **europen:**
Application number: JP19970328684 19971128
Priority number(s):

Abstract of JP10308430

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a substrate processor in which it is possible to easily facilitate a countermeasure to chemicals, and to process a substrate with high quality.

SOLUTION: Wafers are successively processed by a chemicals processing part MTC and a washing and drying processing part DTC, and a clean wafer can be obtained. The carriage of the wafer from an indexer part IND to each processing part MTC and DTC is operated by first and second carrying robots MTR1 and MTR2 constituted of articulated robots. The first and second carrying robots MTR1 and MTR2 can perform access to each processing part MTC and DTC and wafer placing plates P1 and P2 by the bending of the articulates, and seal for a countermeasure to chemicals can be easily attained. Also, the first and second carrying robots MTR1 and MTR2 are provided with two arms each, that is, wafer carrying-in arms B1 and C1 and wafer carrying-out arms B2 and C2. Therefore, the wafers can be held by the different arms at the time of pre-processing and post-processing at each processing part MTC and DTC.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-308430

(43) 公開日 平成10年(1998)11月17日

(51) Int.Cl*	識別記号	P 1
H 01 L 21/68		H 01 L 21/68
B 08 B 3/08		B 08 B 3/08
3/12		3/12
H 01 L 21/304	3 4 1	H 01 L 21/304
		3 4 1 C

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全16頁)

(21) 出願番号	特願平9-328634	(71) 出願人	000207551 大日本スクリーン製造株式会社 京都府京都市上京区坂川通寺之内上る4丁 目天神北町1番地の1
(22) 出願日	平成9年(1997)11月28日	(72) 発明者	柳畠 保廣 京都府京都市伏見区羽束町古川町322番地 大日本スクリーン製造株式会社洛西事業 所内
(31) 優先権主張番号	特願平9-50765	(72) 発明者	渡辺 龍 京都府京都市伏見区羽束町古川町322番地 大日本スクリーン製造株式会社洛西事業 所内
(32) 優先日	平9(1997)3月5日	(74) 代理人	弁理士 稲岡 耕作 (外1名)
(33) 優先権主張国	日本 (J P)		最終頁に続く

(54) [発明の名称] 基板処理装置

(57) [要約]

【課題】液液対策が容易で、基板を高品質に処理できる基板処理装置を提供する。
【解決手段】液液処理部MTCおよび水洗・乾燥処理部DTCによって、順にウエハが処理され、清浄なウエハが得られる。インデクサ部INDから各処理部MTC、DTCへのウエハの搬送は、多間節ロボットからなる第1および第2搬送ロボットMTR1、MTR2によって行われる。第1および第2搬送ロボットMTR1、MTR2は、間節の屈伸により、処理部およびウエハ載置台P1、P2にアクセスすることができるものであり、液液対策のためのシールが容易である。また、第1および第2搬送ロボットMTR1、MTR2は、それぞれ2本のアーム、すなわちウエハ搬入アームB1、C1およびウエハ搬出アームB2、C2を有している。したがって、各処理部での処理前と処理後とで、異なるアームでウエハを保持できる。

